ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДУБНА





5-94 1202/4-78 Ю.Бух, Я.Червенак

ПЛЕНКИ НИТРИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ



P13 - 11057

Ю.Бух, Я.Червенак

ПЛЕНКИ НИТРИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Направлено в "Thin Solid Films"



* Электротехнический институт САН, Б ЧССР.

Братислава,

Бух Ю., Червенак Я.

P13 - 11057

Пленки нитрида кремния полученные плазменным напылением

Описаны пленки Si $_{3}N_{4}$, полученные реактивным плазменным напылением при давлении 2·10⁻⁴ Тор. Дан анализ парциальных давлений газов в рабочем реакторе во время напыления пленок. Определен химический состав получаемых пленок по инфракрасным спектрам пропускания в области длин волн 2,0-15,0 мкм и упругому рассеянию ³He. Самые качественные пленки получены в чистом азоте при минимальном давлении остаточных газов. Главный минимум поглощения в спектрах, соответствующий образованию химических связей Si-N в молекуле Si $_{3}N_{4}$, наблюдался в области 11,0 мкм. В этом случае состав пленок был близок к стехиометрическому. При содержании кислорода парциальное давление которого больше 2%, наблюдалось образование оксид-нитридных пленок, в тех случаях, когда парциальное давление водорода превышало 10%, в пленках нитрида кремния наблюдалось образование дополнительных связей Si-H и N-H .

Работа выполнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1977

Buch J., Červenák J.

P13 - 11057

Silicon Nitride Films Prepared by Reactive Plasmatic Sputtering

The silicon nitride films are prepared by reactive plasmatic sputtering in nitrogen at pressure $2 \cdot 10^{-4}$ torr. The partial pressure of the gas components during sputtering were studied. The films composition by infrared transmission spectra (2.0 - 15.0 μ m) and elastic scattering of ³He (3.0 MeV) were provided. Good quality silicon nitride films can be prepared in clean nitrogen at minimum residual gas pressure. The main peak at 11.0 μ m in the infrared spectra corresponding to chemical connection Si-N in the molecule Si₃N₄ and their element ratio was near to stoichiometric in this case. When the residual oxygen pressure was above 2%, the mixture of oxide-nitride films have been obtained. At residual hydrogen pressure above 10% the origin of new additional chemical connections between Si-H and N-H in the silicon nitride films were observed.

The investigation has been performed at the Department of New Acceleration Methods, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1977

© 1977 Объединенный институт ядерных исследований Дубна

В настоящее время в полупроводниковой технологии для создания электронных схем на основе кремния широко используются пленки нитрида кремния ${\rm Si}_3 {\rm N}_4$. Пиролитический метод получения однородных пленок с высокими электрическими параметрами требует высоких температур - до $1100^{\circ}{\rm C}^{/1-3/}$. Это обстоятельство часто затрудняет применение пленок нитрида кремния, так как нарушает до сих пор хорошо отработанную технологию получения полупроводниковых элементов и интегральных схем.

Нашей задачей в этой работе было получение пленок при комнатных температурах. Для этого мы Si₃N₄ использовали реактивное плазменное напыление. В установке для катодного распыления был создан дополнительный и независимый источник ионизации рабочего газа с магнитным полем / рис. 1/, как описано и в других работах /4, 5/ Это позволило получать пленки нитрида кремния при давлении в рабочем реакторе 2.10⁻⁴ Тор. Такое существенное улучшение вакуума позволило применить во время напыления высокочастотный анализатор парциальных давлений INDITRON /ГДР/. Прибор позволяет анализировать состав остаточных газов при общем давлении 2.10-4 Тор в пределах атомных масс 1-250.

Вакуумный реактор выполнен из кварца $\emptyset = 100 \text{ мм}$, распыляемый катод-мишень - из монокристаллического кремния с удельным сопротивлением $\rho = 100 \text{ Om} \cdot \text{сm}$. Напряжение распыления было постоянным и равным U_p = = 3000 *B*. Напыляемые подложки можно было нагревать до температуры T_H=500°C. Держатель подложек снабжен



Рис. 1. Вакуумный реактор с независимым источником ионизации рабочего газа. Т - мишень из монокристаллического кремния с экранировкой, Н - держатель подложек с подогревом и системой дополнительных электродов, ТК - термокатод источника ионизации, А - цилиндрический анод. РМ - перманентные магниты.

системой заслонок и дополнительных электродов, позволяющих работать на подложках со смещением напряжения. Мишень находилась на расстоянии 45 мм от подложки. Удельная мощность и ток на мишени составляли $1,1 \ Bm \cdot cm^{-2}$ и O,3 мA · cm⁻² соответственно.

Вакуумная система с азотной ловушкой и отжиг реактора до температур 450° С позволяли получить предельный вакуум перед напылением 8.10⁻⁷ *Тор.* Основным компонентом остаточных газов являлся водород, давление которого составляло 86% от общего давления. Конструкция установки позволяла точно регулировать давление рабочих газов аргона и азота в реакторе.

Анализ состава получаемых пленок проводился по инфракрасным /ИК/ спектрам пропускания на автоматическом двухлучевом спектрометре PERKIN-ELMER-221 в области длин волн 2,0-15,0 мкм (ν = 5000-667 см⁻¹). Пленки для этих измерений напылялись на подложки из высокочистого кремния или NaCl.

Главный минимум пропускания в ИК-спектре в области 11,0-12,0 *мкм* отвечает частоте осцилляций атомов Si-N в молекуле Si₃N₄/6-9/. Смещение этого минимума В область более длинных волн и его расширение связывается с уменьшением плотности пленок и деформацией химических связей между атомами /10,11/.В некоторых работах наблюдается дополнительный минимум в области 4,5 *мкм*, что объясняется образованием ненасыщенных химических тройных связей Si-N при высоких скоростях конденсации пленок /10,12/.

Некоторые результаты по получению пленок ${\rm Si}_3 {\rm N}_4$ реактивным плазменным напылением приведены на *рис. 2-6.*



Рис. 2. а.-Инфракрасные спектры пропускания напыляемых пленок /а, в, с/ и подложки из кремния /е/. в.-Соответствующий состав газов в вакуумном реакторе во время напыления.

ИК-спектры пропускания пленок, полученных при давлении $2 \cdot 10^{-4}$ *Тор* в смешанной среде рабочих газов /76% аргона, 10% азота и 14% остаточных газов/, показаны на *рис. 2.* Наблюдается образование неглубокого минимума пропускания в области 12,0 *мкм*, что свидетельствует лишь о частичном образовании новой фазы из Si₃N₄ в пленках.

Пленки Si₃N₄, полученные в чистой азотной среде при давлении остаточных газов до 12%, имели острый



Рис. 3. а.-Инфракрасные спектры пропускания напыляемых пленок Si₃N₄ /a, в, с/ и подложки из кремния /е/. в.-Соответствующий состав газов в вакуумном реакторе во время напыления.



Рис. 4. Энергетические спектры упруго рассеянных частиц ³Не от пленки ${\rm Si}_{3}{\rm N}_{4}$ на кремниевой подложке и от самой подложки. Заштрихованные площади пропорциональны атомным концентрациям азота и кремния в пленке.



Рис. 5. а.-Инфракрасные спектры пропускания напыляемых пленок Si₃N₄ /а,в,с/ и подложки из кремния /е/, получаемые при повышенном содержании водорода. в.-Соответствующий состав газов в вакуумном реакторе во время напыления.



Рис: 6. а.-Инфракрасные спектры пропускания напыляемых оксид-нитридных пленок /а, в, с, d / и подложки из NaCl (e), получаемые при повышенном содержании кислорода. в.-Соответствующий состав газов в вакуумном реакторе во время напыления.

6

минимум пропускания в области 11,0-12,0 *мкм / рис. 3/.* Указанное значение давления остаточных газов соответствовало оптимальным условиям получения нитридных пленок.

Для этих пленок мы определили соотношение их атомных концентраций по энергетическим спектрам упругого рассеяния ³Не / *рис.* 4/, где заштрихованные площади A_N и A_{Si} пропорциональны атомным концентрациям N_N и N_{Si} азота и кремния в пленке $Si_3N_4^{/13,14/2}$

$$\frac{N_{Si}}{N_N} = \frac{A_{Si}}{A_N} \frac{\sigma_N}{\sigma_{Si}} = \frac{11964}{3841} \cdot \frac{3,253 \cdot 10^{-25}}{1,371 \cdot 10^{-24}} = 0,739, /1/$$

$$N_{\rm N} + N_{\rm Si} = 1$$
, /2/

 $\frac{N_N}{N_{Si}} = \frac{0.575}{0.425} = 1.352 \doteq 4:3.$ /3/

Получаемые соотношения атомных концентраций азота и кремния были близки их стехиометрическому соотно-шенню для молекулы $Si_{9}N_{4}$.

И в этом случае качество пленок ${\rm Si}_3{\rm N}_4$ определялось вакуумными условиями /предельным вакуумом, отжнгом, чистотой рабочих газов/. От этих условий зависело давление остаточных газов в реакторе, которое составляло 12-22% от общего давления. Остаточные газы содержали в основном водород, кислород, воду с радикалом ОН, аргон, двуокись водорода и некоторые легкие углероды / CH, CH₂, CH₄/. Наблюдалось также присутствие тяжелых углеродов /с атомными массами больше 120/ от фрагментов масла насосов.

В ряде случаев, когда парциональное давление водорода было больше 10% от общего, на ИК-спектрах наблюдался дополнительный минимум в области от 4,5 до 6,0 *мкм рис.* 5/. Поэтому мы предполагаем, как и в работе $^{/6/}$, что он соответствует образованию химических связей атомов Si-H /область 4,5 *мкм*/ и N-H /область 6,0 *мкм*/. В других случаях, когда парциальное давление кислорода в реакторе превышало 2,0% от общего, наблюдалась конденсация оксид-нитридных пленок / рис.6/. Спектры имеют двойной минимум поглощения, соответствующий образованию химических связей атомов Si-O, область 9,4 мкм/15,16/, н Si-N, область 12,0 мкм, в молекулах пленки. В некоторых спектрах наблюдаются минимумы н в области 4,5 - 6,0 мкм, атакже 3,0 мкм, обусловленные образованием связей Si-H, N-H и Si-OH соответственно.

При работе в смежной среде аргон-кислород с содержанием кислорода до 5% от общего давления /дальнейшее повышение содержания кислорода связано с быстрым выходом термокатодов из строя/ можно было получать пленки двуокиси кремния SiO₂. /puc.7/. Итак, в течение одного вакуумного цикла можно получать многослойные структуры с нитриднымн, оксидными или кремниевыми пленками.



Рис. 7. а.-Инфракрасные спектры пропускания напыляемых пленок SiO₂ /a, в, с, d / и подложки из NaCl(e). в.-Соответствующий состав газов в вакуумном реакторе во время напыления.

Из результатов этой работы видно, что вакуумные условия, а также соотношение содержания рабочего

8

и остаточного газов, определяют условия образования пленок. Повышение парциальных давлений выше 10% для водорода и 2% для кислорода способствует образованию химических связей атомов Si-H, Si-OH, Si-O и в пленках Si₃N₄, существенно изменяющих их N–H электрические свойства.

Не менее серьезным условием, оказывающим большое влияние на скорость образования и состав пленок, имеет и состояние рабочего газа во время синтеза. Так, например. после образования азотной плазмы давление атомарного азота возрастало в три раза по сравнению с начальными условиями. Кислород во время напыления находился также только в атомарном состоянии.

В заключение можно сказать, что освоена методика получения пленок нитрида кремния реактивным плазменным напылением.

Использование самостоятельного источника ионизации рабочего газа позволило получать пленки при давлении 2.10⁻⁴ Тор. В этом случае существует возможность анализировать состав газов в вакуумном реакторе во время напыления пленок с помощью анализатора парциальных давлений.

Состав получаемых пленок анализировался по ИКспектрам пропускания в области длин волн 2,0-15,0 мкм. Обнаружена непосредственная зависимость химического состава пленок от процентного содержания отдельных газов.

Самые качественные пленки нитрида кремния получены в чистом азоте при минимальном давлении остаточных газов /меньше 12%/. Главный минимум пропускания в ИК-спектрах наблюдался в области 11,0 мкм и соответствовал образованию химической связи Si-N в молекуле Si_N ...

Соотношение атомных концентраций азота и кремния по энергетическим спектрам упругого рассеяния ³Не от пленок было близко к их стехнометрическому составу в молекуле Si_oN₄.

В случаях, когда парциальное давление кислорода превышало 2%, наблюдалось образование оксид-нитридных пленок. Если парциальное давление водорода превышало 10%, в пленках нитрида кремния наблюдалось образование и химических связей Si-H, N=H, которые соответствовали поглошению при 4,5 и 6,0 мкм.

При работе в смешанной среде аргон-кислород можно получать пленки двуокиси кремния SiO₂.

Авторы благодарят Г.М.Осетинского за помощь при осуществлении экспериментов по упругому рассеянию **ионов** ³Не.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Doo V. e. a . J. Elchem. Soc., 1968, 115, 61.
- 2. Meyer O., Schrerber W. J. Phys. Chem. Sol., 1971, 32, 1909.
- 3. Gyulai J. e.a. J.Appl.Phys., 1971, 42, 451.
- 4. Cervenák J., Živčaková A., Buch J. Czech.J. Phys. 1970. B-20. 84.
- 5. Fiedler O. e.a. Wiss.Z. Tech. Hochsch, 1970, 12, 483.
- 6. Taft A. J.Elchem.Soc., 1971, 118, 1341.
- 7. Chu L. e.a. J.Elchem.Soc., 1968, 115, 318.
- Seki H., Moriama K. Jap.J.Appl.Phys., 1967, 6, 1345.
 Buch J. Elektrotech.cas., 1973, 24, 188.
- 10. Hu S., Gregor L. J.Elchem.Soc., 1967, 114, 826.
- 11. Chu T. e.a. J.Elchem.Soc., 1967, 114, 717.
- 12. Gereth R., Schrerber W. J.Elchem.Soc., 1972, 119 *1248*.
- 13. Бух Ю. и др. ОИЯИ, Р14-10021, Дубна, 1976.
- 14. Бух Ю. и др. ОИЯИ. Р14-10446, Дубна, 1977.
- 15. Swan R., Pyne A. J.Elchem.Soc., 1969, 116, 1014.
- 16. Kubota T., Kamoshida M. Jap.J.Appl. Phys., 1972, 11, 15.

Рукопись поступила в издательский отдел 3 ноября 1977 года.